

2025-2030年全球及中国IC载板（封装基板）行业发展前景展望与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

——综述篇——

第1章：IC载板综述/产业画像/研究说明

1.1 IC载板行业综述

- 1.1.1 IC载板的界定
 - 1、IC载板是芯片封装的核心载体
 - 2、IC载板技术难度大+进入门槛高
- 1.1.2 IC载板的分类
- 1.1.3 IC载板所处行业
- 1.1.4 IC载板行业监管
- 1.1.5 IC载板行业标准

1.2 IC载板产业画像

- 1.2.1 IC载板产业链结构图
- 1.2.2 IC载板产业链全景图
- 1.2.3 IC载板产业区域热力

1.3 IC载板研究说明

- 1.3.1 本报告研究范围界定
- 1.3.2 本报告专业术语说明
- 1.3.3 本报告权威数据来源
- 1.3.4 研究方法及统计标准

——现状篇——

第2章：全球IC载板行业发展现状分析

2.1 全球IC载板行业发展历程

2.2 全球IC载板市场规模体量

- 2.2.1 全球半导体封装材料市场规模
- 2.2.2 全球半导体封装材料市场结构
- 2.2.3 全球IC载板/封装基板市场规模

2.3 全球IC载板市场供需现状

- 2.3.1 全球IC载板市场发展现状
- 2.3.2 全球IC载板企业及其产品
 - 1、全球IC载板主要企业名单
 - 2、全球IC载板企业产品布局
 - 3、全球IC载板产品布局企业
- 2.3.3 全球IC载板市场需求分析

2.4 全球IC载板细分市场概况

- 2.4.1 全球IC载板细分市场概况
- 2.4.2 全球IC载板下游消费结构
- 2.4.3 全球IC先进封装产线转移
- 2.4.4 全球IC载板下游市场概况——半导体封装/先进封装

2.5 全球IC载板市场竞争态势

- 2.5.1 全球IC载板市场竞争格局
- 2.5.2 全球IC载板市场集中度
- 2.5.3 全球IC载板并购交易态势
- 2.5.4 全球IC载板投融资动态

2.6 全球IC载板区域发展格局

- 2.6.1 全球IC载板区域发展格局
- 2.6.2 全球IC载板区域贸易流向
- 2.6.3 国外IC载板发展经验借鉴

2.7 全球IC载板重点区域市场

- 2.7.1 重点区域IC载板市场概况——日本

- 2.7.2 重点区域IC载板市场概况——韩国
- 2.8 全球IC载板市场前景预测
- 2.9 全球IC载板发展趋势洞悉
- 第3章：中国IC载板行业发展现状分析
 - 3.1 中国IC载板行业发展历程
 - 3.2 中国IC载板市场规模体量
 - 3.3 中国IC载板研发生产模式
 - 3.4 中国IC载板市场主体类型
 - 3.4.1 中国IC载板市场参与者类型
 - 1、由封测厂商投建的企业
 - 2、由PCB厂商拓展业务至封装基板的企业
 - 3、专门生产封装基板的厂商
 - 4、中外合资企业
 - 5、半导体制造商旗下的封装基板企业
 - 6、科研院所或高校背景的企业
 - 3.4.2 中国IC载板企业入场方式
 - 3.5 中国IC载板企业及其产品
 - 3.5.1 中国IC载板企业数量/
 - 3.5.2 中国IC载板企业产品布局
 - 3.6 中国IC载板供给/产能产量
 - 3.6.1 中国IC载板产能投资热度
 - 3.6.2 中国IC载板产能建设项目
 - 3.6.3 中国IC载板生产能力/产能
 - 1、IC载板产能统计
 - 2、IC载板产能变化
 - 3、IC载板在建/拟建产能
 - 4、IC载板规划/扩产计划
 - 3.6.4 中国IC载板生产情况/产量
 - 3.7 中国IC载板外贸/贸易顺差
 - 3.7.1 IC载板适用海关HS编码
 - 3.7.2 中国IC载板对外贸易概况
 - 1、IC载板进出口贸易数量变化
 - 2、IC载板进出口贸易金额变化
 - 3、IC载板进出口贸易差额变化
 - 3.7.3 中国IC载板进口贸易概况
 - 1、IC载板进口贸易规模
 - 2、IC载板进口价格水平
 - 3、IC载板进口来源国
 - 3.7.4 中国IC载板出口贸易概况
 - 1、IC载板出口贸易规模
 - 2、IC载板出口价格水平
 - 3、IC载板出口目的地
 - 3.8 中国IC载板需求/销量价格
 - 3.8.1 中国IC载板销售渠道分析
 - 3.8.2 中国IC载板市场需求特征
 - 3.8.3 中国IC载板市场需求现状（需求量）
 - 1、IC载板需求量变化
 - 2、IC载板主要企业销量
 - 3.8.4 中国IC载板市场供求关系
 - 3.8.5 中国IC载板市场价格水平
 - 3.9 中国IC载板行业经营效益
 - 3.10 中国IC载板行业发展痛点
- 第4章：中国IC载板市场竞争及投融资
 - 4.1 中国IC载板行业竞争态势/战略集群
 - 4.1.1 中国IC载板企业关键成功因素KSF
 - 4.1.2 中国IC载板行业竞争者入场进程
 - 4.1.3 中国IC载板行业竞争者竞争态势
 - 4.1.4 中国IC载板行业竞争者战略集群
 - 4.2 中国IC载板行业竞争强度/激烈程度

- 4.2.1 中国IC载板现有竞争者的竞争强度
- 4.2.2 中国IC载板潜在竞争者的进入威胁
- 4.2.3 中国IC载板行业市场结构集中程度
- 4.3 中国IC载板企业竞争格局/梯队分布**
 - 4.3.1 中国IC载板市场竞争梯队分布
 - 4.3.2 中国IC载板市场竞争格局分析
 - 4.3.3 中国IC载板企业的竞争力对比
- 4.4 中国IC载板企业投资布局/兼并重组**
 - 4.4.1 中国IC载板企业投资布局
 - 4.4.2 中国IC载板企业兼并重组
- 4.5 中国IC载板企业融资动态/IPO**
 - 4.5.1 中国IC载板行业资金来源
 - 4.5.2 中国IC载板企业IPO动态
 - 4.5.3 中国IC载板企业融资事件
 - 4.5.4 中国IC载板企业融资规模
 - 4.5.5 中国IC载板热门融资赛道
- 4.6 IC载板外企在华布局现状/竞争力**
 - 4.6.1 IC载板外企在华布局现状
 - 4.6.2 IC载板外企在华市场竞争力
 - 4.6.3 IC载板外企在华市场竞争策略
- 4.7 中国IC载板国产化进程/国产替代**
 - 4.7.1 中国IC载板国产化进程及国产化率
 - 4.7.2 中国IC载板细分赛道国产替代空间
- 第5章：中国IC载板技术进展及供应链**
 - 5.1 IC载板技术/进入壁垒**
 - 5.1.1 IC载板核心竞争力/护城河——研发+技术+品控
 - 5.1.2 IC载板技术壁垒/进入壁垒
 - 1、技术壁垒
 - 2、认证壁垒
 - 3、资本壁垒
 - 4、原材料壁垒
 - 5.2 IC载板人才/基础研发**
 - 5.2.1 IC载板研发人员数量/科技人才
 - 5.2.2 IC载板技术研发投入/布局方向
 - 5.2.3 IC载板专利申请状况/热门技术
 - 1、IC载板专利申请数量
 - 2、IC载板热门技术聚焦
 - 3、IC载板热门申请机构
 - 5.2.4 IC载板科研创新动态/在研项目
 - 5.2.5 IC载板技术研发方向/未来重点
 - 5.3 IC载板工艺/关键技术**
 - 5.3.1 IC载板生产工艺流程
 - 5.3.2 IC载板技术路线全景
 - 5.3.3 IC载板关键核心技术
 - 5.3.4 IC载板生产加工工艺
 - 5.4 IC载板设计/成本结构**
 - 5.4.1 IC载板产品工业设计
 - 5.4.2 IC载板基本结构组成
 - 5.4.3 IC载板成本结构分析
 - 1、IC封装成本构成
 - 2、IC载板成本构成
 - 5.4.4 IC载板产业价值链图
 - 5.4.5 IC载板的原材料采购
 - 5.5 IC载板基板材料（基材）**
 - 5.5.1 IC载板基板材料（基材）概述
 - 5.5.2 IC载板基板材料（基材）市场概况
 - 5.5.3 IC载板基板材料（基材）——硬质基板材料（BT/ABF/MIS）
 - 1、硬质基板材料概述
 - 2、硬质基板材料市场概况

- 3、硬质基板材料供应商格局
 - 5.5.4 IC载板基板材料（基材）——柔性基板材料（PI/PE）
 - 1、柔性基板材料概述
 - 2、柔性基板材料市场概况
 - 3、柔性基板材料供应商格局
 - 5.5.5 IC载板基板材料（基材）——陶瓷基板材料（氧化铝/氮化铝/碳化硅等）
 - 1、陶瓷基板材料概述
 - 2、陶瓷基板材料市场概况
 - 3、陶瓷基板材料供应商格局
 - 5.5.6 IC载板基板材料（基材）——玻璃基板材料
 - 1、玻璃基板材料概述
 - 2、玻璃基板材料市场概况
 - 3、玻璃基板材料供应商格局
 - 5.6 IC载板其他材料
 - 5.6.1 IC载板其他材料概述
 - 5.6.2 IC载板其他材料——电解铜箔
 - 1、电解铜箔概述
 - 2、电解铜箔市场概况
 - 3、电解铜箔供应商格局
 - 5.6.3 IC载板其他材料——化学品/耗材
 - 1、化学品/耗材概述
 - 2、化学品/耗材市场概况
 - 3、化学品/耗材供应商格局
 - 5.7 IC载板生产设备
 - 5.7.1 IC载板生产设备概述
 - 5.7.2 IC载板生产设备市场概况
 - 5.7.3 IC载板生产设备供应商格局
 - 5.7.4 IC载板生产设备——LDI设备
 - 1、LDI设备概述
 - 2、LDI设备市场概况
 - 3、LDI设备供应商格局
 - 5.7.5 IC载板生产设备——AOI检测设备
 - 1、AOI检测设备概述
 - 2、AOI检测设备市场概况
 - 3、AOI检测设备供应商格局
 - 5.9 IC载板检验检测
 - 5.9.1 IC载板工业过程检测/在线检测/智能检测技术/AOI检测
 - 5.9.2 IC载板检验检测服务业/第三方检测服务市场概况
 - 5.10 IC载板供应链管理及面临挑战
- 第6章：中国IC载板细分市场发展分析**
- 6.1 IC载板行业细分市场概况
 - 6.1.1 IC载板替代品的威胁
 - 6.1.2 IC载板产品综合对比
 - 6.1.3 IC载板细分市场概况
 - 6.1.4 IC载板细分市场结构
 - 6.2 IC载板细分市场：硬质基板
 - 6.2.1 硬质基板概述
 - 6.2.2 硬质基板市场概况
 - 6.2.3 硬质基板——ABF载板
 - 1、基本情况
 - 2、市场概况
 - 3、供应商格局
 - 6.2.4 硬质基板——BT载板
 - 1、基本情况
 - 2、市场概况
 - 3、供应商格局
 - 6.2.5 硬质基板——MIS载板
 - 1、基本情况
 - 2、市场概况

- 3、供应商格局
- 6.2.6 硬质基板发展趋势
- 6.3 IC载板细分市场：柔性基板**
 - 6.3.1 柔性基板概述
 - 6.3.2 柔性基板市场概况
 - 6.3.3 柔性基板竞争格局
 - 6.3.4 柔性基板发展趋势
- 6.4 IC载板细分市场：陶瓷基板**
 - 6.4.1 陶瓷基板概述
 - 6.4.2 陶瓷基板市场概况
 - 6.4.3 陶瓷基板竞争格局
 - 6.4.4 陶瓷基板发展趋势
- 6.5 IC载板细分市场：玻璃基板**
 - 6.5.1 玻璃基板概述
 - 6.5.2 玻璃基板市场概况
 - 6.5.3 玻璃基板竞争格局
 - 6.5.4 玻璃基板发展趋势
- 6.6 IC载板细分市场战略地位分析**
- 第7章：中国IC载板细分应用市场分析**
 - 7.1 IC载板潜在应用场景/主要应用领域**
 - 7.1.1 IC载板潜在应用场景
 - 7.1.2 IC载板应用领域分布
 - 7.2 IC载板应用：存储芯片封装基板（eMMC）**
 - 7.2.1 存储芯片封装基板（eMMC）概述
 - 7.2.2 存储芯片封装基板（eMMC）市场现状
 - 7.2.3 存储芯片封装基板（eMMC）需求潜力
 - 7.3 IC载板应用：微机电系统封装基板（MEMS）**
 - 7.3.1 微机电系统封装基板（MEMS）概述
 - 7.3.2 微机电系统封装基板（MEMS）市场现状
 - 7.3.3 微机电系统封装基板（MEMS）需求潜力
 - 7.4 IC载板应用：射频模块封装基板（RF）**
 - 7.4.1 射频模块封装基板（RF）概述
 - 7.4.2 射频模块封装基板（RF）市场现状
 - 7.4.3 射频模块封装基板（RF）需求潜力
 - 7.5 IC载板应用：处理器芯片封装基板**
 - 7.5.1 处理器芯片封装基板概述
 - 7.5.2 处理器芯片封装基板市场现状
 - 7.5.3 处理器芯片封装基板需求潜力
 - 7.6 IC载板应用：高速通信封装基板**
 - 7.6.1 高速通信封装基板概述
 - 7.6.2 高速通信封装基板市场现状
 - 7.6.3 高速通信封装基板需求潜力
 - 7.7 IC载板细分应用战略地位分析**
- 第8章：全球及中国IC载板企业案例解析**
 - 8.1 全球及中国IC载板企业梳理对比**
 - 8.2 全球IC载板企业案例分析（不分先后，可指定）**
 - 8.2.1 日本揖斐电IBIDEN
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况
 - 3、企业IC载板业务布局
 - 4、企业IC载板在华布局
 - 8.2.2 韩国三星电机
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况
 - 3、企业IC载板业务布局
 - 4、企业IC载板在华布局
 - 8.2.3 奥地利AT&S奥特斯
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况

- 3、企业IC载板业务布局
- 4、企业IC载板在华布局
- 8.2.4 韩国SMMTECH信泰
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况
 - 3、企业IC载板业务布局
 - 4、企业IC载板在华布局
- 8.2.5 韩国Daeduck大德
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况
 - 3、企业IC载板业务布局
 - 4、企业IC载板在华布局
- 8.3 中国IC载板企业案例分析（不分先后，可指定）**
 - 8.3.1 深南电路股份有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 经营情况
 - (2) 产品结构
 - (3) 销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业IC载板产品/业务布局
 - 6、企业IC载板应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
 - 8.3.2 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 经营情况
 - (2) 产品结构
 - (3) 销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业IC载板产品/业务布局
 - 6、企业IC载板应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
 - 8.3.3 东旭光电科技股份有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 经营情况
 - (2) 产品结构
 - (3) 销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业IC载板产品/业务布局
 - 6、企业IC载板应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
 - 8.3.4 欣兴电子股份有限公司（中国台湾）
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 经营情况
 - (2) 产品结构
 - (3) 销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业IC载板产品/业务布局

- 6、企业IC载板应用/客户布局
- 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.5 南亚电路板股份有限公司（中国台湾）
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 经营情况
 - (2) 产品结构
 - (3) 销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业IC载板产品/业务布局
 - 6、企业IC载板应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.6 景硕科技股份有限公司（中国台湾）
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 经营情况
 - (2) 产品结构
 - (3) 销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业IC载板产品/业务布局
 - 6、企业IC载板应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.7 日月光半导体（上海）有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 经营情况
 - (2) 产品结构
 - (3) 销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业IC载板产品/业务布局
 - 6、企业IC载板应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.8 珠海越亚半导体股份有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 经营情况
 - (2) 产品结构
 - (3) 销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业IC载板产品/业务布局
 - 6、企业IC载板应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.9 东莞康源电子有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 经营情况
 - (2) 产品结构
 - (3) 销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术

- 5、企业IC载板产品/业务布局
- 6、企业IC载板应用/客户布局
- 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.10 胜宏科技（惠州）股份有限公司
 - 1、企业基本信息
 - 2、企业经营情况及投融资
 - (1) 经营情况
 - (2) 产品结构
 - (3) 销售区域
 - (4) 融资历程/对外投资
 - 3、企业经营资质/能力资质
 - 4、企业研发投入/专利技术
 - 5、企业IC载板产品/业务布局
 - 6、企业IC载板应用/客户布局
 - 7、企业发展战略&优劣势

——展望篇——

第9章：中国IC载板政策环境及发展潜力

9.1 中国IC载板行业政策汇总解读

- 9.1.1 中国IC载板行业政策汇总
- 9.1.2 中国IC载板行业发展规划
- 9.1.3 中国IC载板重点政策解读
- 9.1.4 各省市IC载板政策热力图
- 9.1.5 各省市IC载板政策规划汇总
- 9.1.6 各省市IC载板发展目标解读

9.2 中国IC载板行业PEST环境分析

- 9.2.1 中国IC载板政策环境总结
- 9.2.2 中国IC载板技术环境总结
- 9.2.3 中国IC载板经济环境分析
- 9.2.4 中国IC载板社会环境分析

9.3 中国IC载板行业PEST分析图

9.4 中国IC载板行业SWOT分析图

9.5 中国IC载板行业发展潜力评估

第10章：中国IC载板前景预测及发展趋势

10.1 中国IC载板行业未来关键增长点

10.2 中国IC载板行业发展前景预测

10.3 中国IC载板行业发展趋势洞悉

- 10.3.1 中国IC载板行业整体发展趋势
- 10.3.2 中国IC载板行业监管规范趋势
- 10.3.3 中国IC载板行业技术创新趋势
- 10.3.4 中国IC载板行业细分市场趋势
- 10.3.5 中国IC载板行业市场竞争趋势
- 10.3.6 中国IC载板行业市场供需趋势

第11章：中国IC载板行业投资机会及建议

11.1 中国IC载板行业投资风险预警

- 11.1.1 中国IC载板行业投资风险预警
- 11.1.2 中国IC载板行业投资风险应对

11.2 中国IC载板行业投资机会分析

- 11.2.1 中国IC载板产业链薄弱环节投资机会
- 11.2.2 中国IC载板行业细分领域投资机会
- 11.2.3 中国IC载板行业区域市场投资机会
- 11.2.4 中国IC载板产业空白点投资机会

11.3 中国IC载板行业投资价值评估

11.4 中国IC载板行业投资策略建议

11.5 中国IC载板行业可持续发展建议

图表目录

- 图表1: IC载板是芯片封装的核心载体
图表2: IC载板技术难度大+进入门槛高
图表3: IC载板的分类
图表4: IC载板所处行业
图表5: 中国IC载板监管体系建设
图表6: 中国IC载板监管组织机构
图表7: 中国IC载板标准体系建设
图表8: 中国IC载板现行标准汇总
图表9: IC载板产业链结构示意图
图表10: IC载板产业链生态全景图
图表11: IC载板产业链区域热力图
图表12: 本报告研究范围界定
图表13: 本报告专业术语说明
图表14: 本报告权威数据来源
图表15: 本报告研究统计方法
图表16: 全球IC载板行业发展历程
图表17: 全球IC载板市场规模体量
图表18: 全球IC载板市场发展现状
图表19: 中国IC载板主要企业名单
图表20: 全球IC载板企业产品布局
图表21: 全球IC载板产品布局企业
图表22: 全球IC载板市场需求分析
图表23: 全球IC载板细分市场概况
图表24: 全球IC载板下游消费结构
图表25: 全球IC先进封装产线转移
图表26: 全球IC载板下游市场概况
图表27: 全球IC载板市场竞争格局
图表28: 全球IC载板市场集中度
图表29: 全球IC载板并购交易态势
图表30: 全球IC载板投融资动态
图表31: 全球IC载板区域发展格局
图表32: 全球IC载板区域贸易流向
图表33: 国外IC载板发展经验借鉴
图表34: 日本IC载板行业发展概况
图表35: 韩国IC载板行业发展概况
图表36: 全球IC载板市场前景预测（未来五年）
图表37: 全球IC载板发展趋势洞悉
图表38: 中国IC载板行业发展历程
图表39: 中国IC载板行业市场规模体量
图表40: 中国IC载板研发生产模式
图表41: 中国IC载板市场参与者类型
图表42: 中国IC载板企业入场方式
图表43: 中国IC载板企业数量名单
图表44: 中国IC载板企业产品布局
图表45: 中国IC载板产能投资/建设
图表46: 中国IC载板生产能力/产能
图表47: 中国IC载板生产情况/产量
图表48: 中国IC载板适用海关编码
图表49: 中国IC载板对外贸易概况
图表50: 中国IC载板进口贸易概况
图表51: 中国IC载板出口贸易概况
图表52: 中国IC载板需求/市场销售
图表53: 中国IC载板销售渠道分析
图表54: 中国IC载板市场需求现状（需求量）
图表55: 中国IC载板市场供求关系

- 图表56: 中国IC载板市场价格走势
- 图表57: 中国IC载板行业发展痛点
- 图表58: 中国IC载板关键成功因素KSF
- 图表59: 中国IC载板行业竞争者入场进程
- 图表60: 中国IC载板行业竞争者竞争态势
- 图表61: 中国IC载板行业竞争者战略集群
- 图表62: 中国IC载板现有竞争者的竞争强度
- 图表63: 中国IC载板潜在竞争者的进入威胁
- 图表64: 中国IC载板行业的市场集中度
- 图表65: 中国IC载板市场竞争梯队分布
- 图表66: 中国IC载板市场竞争格局分析
- 图表67: 中国IC载板企业的竞争力对比
- 图表68: 中国IC载板企业投资布局
- 图表69: 中国IC载板企业兼并重组
- 图表70: 中国IC载板行业资金来源
- 图表71: 中国IC载板企业IPO动态
- 图表72: 中国IC载板企业融资事件
- 图表73: 中国IC载板企业融资规模
- 图表74: 中国IC载板热门融资赛道
- 图表75: IC载板外企在华布局现状/竞争力
- 图表76: IC载板外企在华布局动态
- 图表77: IC载板外企在华市场竞争力
- 图表78: IC载板外企在华市场竞争策略
- 图表79: IC载板核心竞争力/护城河
- 图表80: IC载板技术壁垒/进入壁垒
- 图表81: IC载板技术研发投入/布局方向
- 图表82: IC载板专利申请状况/热门技术
- 图表83: IC载板科研创新动态/在研项目
- 图表84: IC载板技术研发方向/未来重点
- 图表85: IC载板场工艺流程
- 图表86: IC载板技术路线全景图
- 图表87: IC载板关键核心技术
- 图表88: IC载板生产加工工艺
- 图表89: IC载板产品工业设计
- 图表90: IC载板的结构示意图
- 图表91: IC载板成本结构分析
- 图表92: IC载板的原材料采购
- 图表93: IC载板基板材料（基材）概述
- 图表94: IC载板原材料的价格波动
- 图表95: IC载板其他材料概述
- 图表96: IC载板生产设备类型
- 图表97: IC载板生产设备市场概况
- 图表98: IC载板检验检测服务业/第三方检测服务市场概况
- 图表99: IC载板供应链管理及面临挑战
- 图表100: IC载板替代品的威胁
- 图表101: IC载板产品综合对比
- 图表102: 中国IC载板细分市场概况
- 图表103: 中国IC载板细分市场结构
- 图表104: 硬质基板概述
- 图表105: 硬质基板市场概况
- 图表106: 硬质基板竞争格局
- 图表107: 硬质基板发展趋势
- 图表108: 柔性基板概述
- 图表109: 柔性基板市场概况
- 图表110: 柔性基板竞争格局
- 图表111: 柔性基板发展趋势
- 图表112: 陶瓷基板概述
- 图表113: 陶瓷基板市场概况
- 图表114: 陶瓷基板竞争格局

图表115：陶瓷基板发展趋势
图表116：玻璃基板概述
图表117：玻璃基板市场概况
图表118：玻璃基板竞争格局
图表119：玻璃基板发展趋势
图表120：IC载板细分市场战略地位分析
略••••完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！